

SEMI Circuit Design Speed Contest 2026



「SEMI Circuit Design Speed Contest 2026」募集要項

1. 開催趣旨

世界的に重要性が高まるエレクトロニクス産業において、将来の活躍が期待される人材を育成することを目的として、全国の高等専門学校を学生を対象とした半導体設計に関する競技会を開催する。

本取組は、国立高等専門学校機構が主導する「COMPASS 5.0(次世代基盤技術教育のカリキュラム化)」の一環として位置づけられており、Society 5.0時代に求められる高度な実践力と応用力を備えた人材の育成を図るとともに、学生の主体的な学修成果を実践の場で発揮し、半導体分野への理解と関心を一層深める機会とする。

2. 日時・会場

(1) 親睦予選会

- ① 日時(実施期間) 令和8年9月1日(火) ~ 令和8年10月30日(金)
- ② 会場 各高専のキャンパス内

(2) 全国大会

- ① 日時 令和8年12月10日(木) 9:30 ~ 13:00
- ② 会場 東京ビッグサイト 会議棟1F

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1 TEL 03-5530-1111

3. 募集競技

SEMI Circuit Design Speed Contest

競技① CIRCUIT DESIGNER^{※1}でタイムアタック!

競技② インバーター回路設計 スピードコンテスト

【概要】

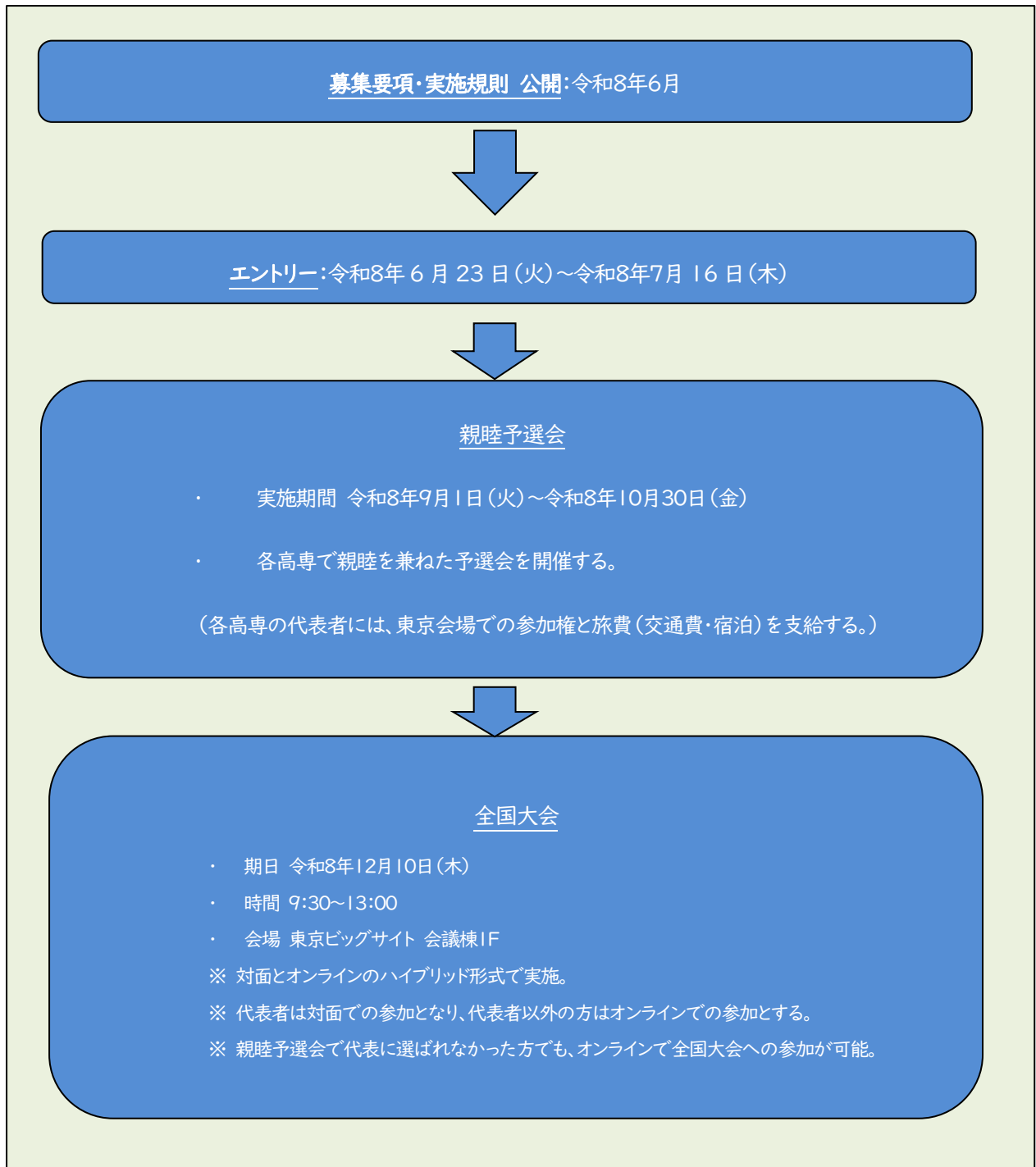
- ① CIRCUIT DESIGNERを使用して、メタバース上で半導体製造工程の速さを競う。
 - ② SX-Meister^{※2}を使用して、半導体回路設計の速さと正確さを競う。
- ※1 メタバース内で半導体・集積回路の設計・製造の過程をシューティングゲーム形式で学ぶツール
※2 半導体・集積回路の動作をシミュレーションし、設計内容の検証や解析を行うツール

4. 応募資格

SEMI Circuit Design Speed Contest

全国の高等専門学校に在籍する学生とし、個人での参加とする。また、同一校から複数名の参加を認める。
なお、コンテストで使用するツールを利用できる環境が整っている学校に在籍していることを条件とする。

5. 応募の流れ



6. 旅費

競技に係る学生及び引率者の交通費、宿泊費は、出場者個人の負担とする。なお、競技②インバーター回路設計コンテスト全国大会(決勝)出場者については、主催者より、東京までの往復旅費(交通費、宿泊)を支給する。交通費支給については、各地方の拠点(札幌、大阪、福岡など)から東京までとする。(航空機、新幹線を利用の場合のみ)よって自宅から各地方の拠点まで、および東京都内の交通費は自己負担となる。支給方法の詳細は別途コンテスト申込者に通知する。

7. 実施方法

① エントリー

- ① 参加する学校は、本要項に基づき、令和8年6月23日(火)から7月16日(木)までに、所定の Microsoft Formsにより参加申込みを行うこと。申込フォームURLは以下のとおりとする。
申込フォームURL: <https://forms.cloud.microsoft/r/3REZ8vaZEC>
- ② 受付後、大会事務局から参加校代表者へ受付完了メールを送信する。受付完了メールが7月17日(金)までに届かない場合は、大会事務局に確認すること。
- ③ エントリーシートは、前項の受付完了メールに添付して案内するものとし、参加校は、参加学生の氏名その他必要事項を記入のうえ、提出すること。なお、提出時期及び提出方法は、当該メールにて案内する。
- ④ 募集要項等に関する問合せは、大会事務局へ電話または電子メールにて行う。

② 親睦予選会

親睦を兼ねた予選会は、すべての競技について、対面参加のみの形式で実施する。参加者は各高専にて、派遣された運営スタッフの指示に従い、競技を実施する。

- ① エントリーシートに記載のある参加者による個人戦を行う。
- ② 参加者多数の場合、予選参加者を調整する場合がある。
その際は、対象の学校へ別途連絡する。
- ③ 今回予選実施にあたりスポンサーを募り各校での開催をご支援いただくことを想定している。スポンサー企業の要望により各高専またはオンラインで応援のメッセージを発信いただく場合がある。その際は、対象の学校へ別途連絡する。
- ④ 各校での予選実施について主催よりプレスリリースを行い広く周知を行う。取材依頼がある場合は、事前に主催より連絡をする。

③ 全国大会

全国大会は、親睦予選会同様、個人戦を行う。

いずれの競技においても、対面参加とオンライン参加のハイブリッド形式で実施する。

代表者は対面での参加となり、代表者以外の方はオンラインでの参加となる。

なお、代表者として選ばれなかった方も、オンラインにて参加が可能である。

オンライン参加の場合の実施方法や注意事項については、別途案内する。

対面参加の場合は競技で使用する機材については大会事務局にて準備する。

④ 表彰

競技①、競技②のそれぞれについて、優勝・準優勝・第3位を各1名ずつ決定し、表彰するとともに副賞を授与する。

8. 個人情報の取り扱い

- ① 本コンテストの申込み及び運営にあたり取得した参加者の個人情報は、以下の目的で主催者及び運営事務局が適切に管理・利用する。
 - 本コンテストの運営・連絡・審査
 - 結果公表・広報・記録作成・報告書作成
 - その他、本コンテストの目的の達成のため必要な業務
- ② 主催者又は運営事務局が、開催状況・受賞結果等を大会ホームページ、広報資料、報告書、プレスリリース等に掲載する場合がある。
- ③ 法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を本人の同意なく上記目的以外に利用し、又は第三者に提供しない。
- ④ 本コンテストへの参加をもって、上記の個人情報の取り扱いに同意したものとみなす。なお、写真・動画の撮影・使用にあたっては、別途本人の了承を得る場合がある。

9. 大会事務局(応募・問合せ先)

組織名	連絡先	担当者
運営事務局	TEL:0952-97-6100 E-mail:cogakusee.info@gakusee.jp	木村情報技術株式会社

主催:SEMI Japan

HP <https://www.semi.org/jp>

コンテストHP <https://www.semiconjapan.org/jp/workforce/circuit-design>

後援(申請中):文部科学省・経済産業省・独立行政法人国立高等専門学校機構

協力:有明工業高等専門学校・サーキットデザイン教育センター(CDEC)

運営事務局:SEMI Circuit Design Speed Contest 運営事務局(運営:木村情報技術株式会社)

※ 木村情報技術株式会社がSEMIより、委託を受けて企画運営をしております。